

半導体用Ptfеクリーニングバスケット

12インチウェハーウェットエッチングラック

耐酸耐アルカリフッ素樹脂キャリア

商品番号: PL-CP81



前書き

高純度半導体環境向けに設計されたこの12インチPTFEウェハークリーニングバスケットは、重要なウェットエッチングおよびクリーニングプロセス中に卓越した耐薬品性を保証します。カスタム製造のデザインは、信頼性の高いウェハーサポートと、精密製造のための最大限の液暴露を提供します。

詳細を学ぶ

アプリケーション	説明	主なメリット
RCAクリーニング	有機汚染物質と金属不純物を除去するための標準化されたシーケンス（SC-1およびSC-2）。	高pHと低pHの移行中の再汚染を防ぎます。
HFエッチング	フッ化水素酸溶液を使用した犠牲酸化層または自然酸化膜の除去。	HF攻撃に対する完全な免疫は、装置の長寿命を保証します。
ピラニアエッチング	レジスト除去のための硫酸と過酸化水素の高温混合。	構造的な軟化なしに激しい発熱反応に耐えます。
CMP後リンス	化学機械研磨（CMP）に続くスラリー粒子と化学物質の除去。	最小限の接触点は、ウェハーの後ろでの粒子の捕捉を防ぎます。
太陽電池テクスチャリング	光吸収を向上させるための大口径シリコンウェハーの酸またはアルカリテクスチャリング。	連続的な化学物質暴露環境での大容量耐久性。
MEMSファブリケーション	微小機械構造を作成するためのシリコンまたはガラス基板の深いウェットエッチング。	最適化された流体循環を通じて均一なエッチング速度を保証します。
フォトリソグラフィ	特殊な有機溶剤を使用したフォトレジスト材料の現像およびストリッピング。	耐溶剤性材料は、現像液への有機物の浸出を防ぎます。
メガソニッククリーニング	ウェハー表面からサブミクロン粒子を除去するための高周波音響クリーニング。	材料密度は、減衰効果なしに音響エネルギーを効果的に伝達します。

機能	仕様詳細（PL-CP81）
主な材料	高純度バージンPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
ウェハー径互換性	300mm（12インチ） - 要望によりカスタムサイズ可能
構成	単一ウェハーキャリア / マルチウェハーフラワーバスケット構成
製造プロセス	精密CNC加工 / 特注製造
耐薬品性	全範囲（pH 0-14）；HF、HNO ₃ 、HCl、H ₂ SO ₄ 、KOHなどに耐性
使用温度	260°Cまでの連続使用（デザインに基づくカスタム制限）
スロットピッチ / 間隔	流体フローまたは容量要件を満たすために完全にカスタマイズ可能
接触タイプ	点接触またはエッジ接触デザインが利用可能

機能	仕様詳細 (PL-CP81)
ハンドルオプション	固定、取り外し可能、または自動ロボットフランジインターフェース
表面仕上げ	粒子付着を最小限に抑えるための超滑らかな加工仕上げ
純度基準	セミグレード準拠；微量金属分析が可能